

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-043

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和发展的需要，根据公司经营战略及发展计划，公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元（含目前生效的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准），该综合授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。

为提高工作效率，董事会授权由公司董事长HUI WANG在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度是公司日常经营及业务发展所需，对公司正常经营不构成重大影响，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日